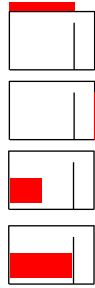


SMT

Werbebanner auf www.SMT-Verlag.de

emv-esd

CADS



Typ	Größe in Pixel	Formate	Preise pro Woche
Super Banner	728 x 90	GIF/JPG/Flash	300 €
Wide Skyscraper	160 x 600	GIF/JPG/Flash	250 €
Rectangle	180 x 150	GIF/JPG/Flash	150 €
Medium Rectangle	300 x 250	GIF/JPG/Flash	250 €

Sie können selbstverständlich auch jedes andere Format wählen, inklusive Video. Bitte fragen sie bei uns an!

Redaktion

Dipl.-Ing. Jost Dennier
info@smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 4
55218 Ingelheim
Tel: 06132 4316-47
Fax: 06132 4316-49

Vertrieb

info@smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1
55218 Ingelheim
Tel: 06132 4316-47
Fax: 06132 4316-49

Anzeigenverkauf

Tel: 06132 4316-47
Fax: 06132 4316-49
E-mail: info@smt-verlag.de

MEDIADATEN 2015

THEMEN
TERMINE
PREISE

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung

SMT

emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT & AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

CADS

CAE/CAD/CAM/CAQ

SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG
 JAHRGANG 27
 OKTOBER 2014
 WWW.SMT-VERLAG.DE
 30974
 10 **SMT** + CADS 3
ASM ASSEMBLY SYSTEMS – MATERIALFLUSS-OPTIMIERUNG WIRD ZENTRALE AUFGABE
 Auswahl der Testsysteme für Flachbaugruppen Marktübersicht Bestücksysteme Leistungselektronik: DC-Stromversorgungs-Integrität? (Teil 2) Systemsimulationen mit dem Vivado-IP-Integrator

- **Herausgeber:** Jost Dennier
- **Redaktion:** Jost Dennier
Anschrift: Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD
Oberer Schenkgarten 1
55218 Ingelheim
Tel.: (0 61 32) 43 16 47
Fax: (0 61 32) 43 16 49
E-Mail: info@smt-verlag.de
- **Anzeigen:** Telefon: (0 613 2) 43 16 47,
Anschrift: Fax: (0 61 32) 43 16 49
E-Mail: info@smt-verlag.de
- **Inhaber:** Jost Dennier
- **Verlag:** SMT-VERLAG
Oberer Schenkgarten 1
55218 Ingelheim
- **Jahrgang:** 28. Jahrgang 2015
- **Erscheinungsweise:** 8 x jährlich
- **Erscheinungs-/Redaktionsplan:** siehe Seite 5/6
- **Bezugspreise:**

Jahresabonnement:	58,00 Euro inkl. Versand
Einzelheft:	9,00 Euro
Jahresabo: EMV-ESD bzw. CADS	29,00 Euro inkl. Versand

■ Kurzcharakteristiken:

»SMT Germany« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert über die Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik. Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei der Anwendung von CA-Techniken inklusive CAE/CAD/CAM/CAT/CAQ.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

Zielgruppen sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren Erzeugnissen einsetzen.

■ **Auflagen-Analyse:** Intern (30.09.2013 -01.10.2014)

■ **Druckauflage:** 9500

■ **Tatsächlich verbreitete Auflage**

im Jahresdurchschnitt: 9216

■ **Verkaufte Auflage:** 945

■ **Freistücke:** 8271 pro Ausgabe

■ **Rest-, Archiv- und Belegexemplare:** 284 pro Ausgabe

■ Geographische Verbreitungsanalyse

Wirtschaftsraum	Anteil an der Auflage in %	
Inland		
Postleitzahl 0	211	2,3
Postleitzahl 1	304	3,3
Postleitzahl 2	522	5,7
Postleitzahl 3	715	7,8
Postleitzahl 4	643	7,0
Postleitzahl 5	741	8,0
Postleitzahl 6	1131	12,3
Postleitzahl 7	1997	21,7
Postleitzahl 8	1609	17,5
Postleitzahl 9	816	8,9
Ausland		
Schweiz	131	1,4
Österreich	112	1,2
Großbritannien	80	0,9
Niederlande	83	0,9
Sonstiges Ausland	121	1,3
Gesamtauflage	9216	100,0

Branchen-/Wirtschaftszweige

Nr. Grundsystematik	Empfängergruppen	Exemplare	%
242	Maschinenbau	643	7,0
243	Datenverarbeitung/ Büromaschinen	167	1,8
244	Fahrzeugbau	249	2,7
248	Luft- und Raumfahrt	279	2,3
250	Elektronikfertigung	3797	41,2
	Unterhaltungselektronik	157	1,7
	Medizin techn. / Optik	314	3,4
	Leiterplattenhersteller	241	2,6
	Ing. Büros/Dienstleistung	1161	12,6
	Mess- und Regeltechnik	413	4,5
5	Nachrichtentechnik / Verkehr	829	9,0
	Bauelemente-Hersteller	227	2,5
	Stromerzeugung	51	0,6
9	Ausbildung / Forschung	628	6,8
	Sonstige Branchen	60	0,7
Tatsächlich verbreitete Auflage		9216	100,0

Betriebsgröße

	Exemplare	%
1 bis 9 Beschäftigte	1490	16,2
10 bis 49 Beschäftigte	1133	12,3
50 bis 99 Beschäftigte	767	8,3
100 bis 499 Beschäftigte	2266	24,6
500 bis 999 Beschäftigte	821	8,9
1000 und mehr Beschäftigte	2739	29,6
Gesamt	9216	100

Betriebliche Funktion

	Exemplare	%
Unternehmensleitung	613	6,7
Techn. Management	2176	23,6
Forschung/Entwicklung	2439	26,5
Konstruktion	708	7,7
Fertigung	1981	21,5
Qualitätskontrolle, Test	518	5,6
Verkauf	304	3,3
Marketing / Werbung	402	4,4
Studenten	46	0,5
Hochschulen/Sonstige	22	0,2
Gesamt	9216	100,0

Zeitschriftenformat: DIN A4 210 breit x 297 hoch mm
Anschnitt 216 breit x 303 hoch mm

Satzspiegel: 185 breit x 260 hoch mm

Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro

Format	Breite x Höhe	Maße angeschnitten	Anzeigen pro Jahr					
			bei	1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 x 260	216 x 303		3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00
3/4- Seite	140 x 260 oder 185 x 195	146 x 303		2.900,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 x 303		2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
1/2 Juniorpage	135 x 195	138 x 198		2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133		1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x 90		1.450,00	1.250,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303		1.030,00	980,00	920,00	880,00	820,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36		530,00	504,00	474,00	440,00	430,00
1/16- Seite	46 x 62 oder 93 x 31			360,00	340,00	324,00	303,00	285,00

Preise für Vorzugsplätze: 2., 3. und 4. Umschlagseite +15%
Sonstige Platzierungsvorschrift: +10% auf den Grundpreis
Anschnittzuschläge werden **nicht** berechnet

Farbzuschläge:

Format	2-farbig (Skala)	3-farbig	4-farbig	Sonderfarbe
1/1 oder kleiner	390,00	750,00	950,00	600,00
1/2 oder kleiner	300,00	580,00	750,00	600,00
1/4 oder kleiner	250,00	450,00	550,00	600,00

Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 3,00

Bankverbindung:

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00
BIC-Code: MVBMD55 IBAN: DE8355190000787587013

Zahlungsbedingungen: Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder 20 Tage ohne Abzug.

Einhefter/Einkleber:

Papiergewicht: 80 bis 120 g/m²

2 Seiten (nur Einkleber)	4 Seiten	6 Seiten	8 Seiten
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00

Beilagen: Teilbeilagen sind möglich

bis 25 g/1000 inkl. Porto 270,00	bis 50 g/1000 inkl. Port 370,00
-------------------------------------	------------------------------------

Druckverfahren: Offset

Druckunterlagen: PDF- und eps-Dateien als Druckunterlagen werden bevorzugt.

Versandanschrift: SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,
55218 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649,
E-Mail: info@smt-verlag.de

Aufträge gemäß den Standard-Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.

Termine	Schwerpunkthemen SMT	Schwerpunkte CADS	Schwerpunkte EMV-ESD	Messen
Ständige Schwerpunkte	Advanced Packaging Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Marktübersichten	EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, -synthese, Simulation	Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen	
Januar/ Februar mit EMV-ESD 1 Messeheft EMV 2015 Redaktionsschluss 19.02.2015 Anzeigenschluss 27.02.2015 Erscheinungstermin 04.03.2015	Bestücktechnik, Photovoltaik-Produktion Leiterplatten, Microvias, HDI Packaging, Bonding AOI, AXI, Flying Prober Marktübersicht: Steckverbinder		Vorschau EMV 2015 Messtechnik Filter, Stromversorgung Gehäuse ESD, Produktsicherheit Störfestigkeit	APEX 28.02 - 01.03.2015 Las Vegas EMV 2015 24.03. - 26.03.2015 Stuttgart
März mit CADS 1 Redaktionsschluss 13.03.2015 Anzeigenschluss 20.03.2015 Erscheinungstermin 30.03.2015	Vorberichte » SMT Hybrid Packaging « Reparatur/Rework, Löttechnik, Bestücktechnik, Photovoltaik Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer, Reinraumtechnik Baugruppentest, Halbleitertest, AOI Marktübersicht: Lohnfertiger	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		CoBIT 16.03. - 20.03.2015 Hannover Hannover Messe 13.04. - 17.04.2015 Hannover
April/Mai mit EMV-ESD 2 Messeheft SMT/ Hybrid/ Packaging Redaktionsschluss 10.04.2015 Anzeigenschluss 17.04.2015 Erscheinungstermin 24.04.2015	Vorberichte » SMT Hybrid Packaging « Löttechnik, Selektiv-Löten Dispensen, Bestückung MCM, Photovoltaik-Produktion Board-Test, ICT, AOI, AXI Marktübersicht: Lötssysteme		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1 Nachbericht EMV 2015 Messtechnik Antennen Stromversorgung Produktsicherheit	SMT/Hybrid/ Packaging 2015 05.05. - 07.05.2015 Nürnberg
Juni/ Juli mit CADS 2 Redaktionsschluss 12.06.2015 Anzeigenschluss 19.06.2015 Erscheinungstermin 29.06.2015	Nachberichte » SMT Hybrid Packaging « Packaging, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck AOI, AXI Marktübersicht: Schablonendruck	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		inter solar 2015 10.06. - 12.06.2015 München parts2clean 2015 09.06. - 11.06.2015 Stuttgart
August/ September mit EMV-ESD 3 Redaktionsschluss 21.08.2015 Anzeigenschluss 28.08.2015 Erscheinungstermin 07.09.2015	Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, AOI, AXI, Flying Prober, Testautomation Packaging, Chip-on-Board, Rework Marktübersicht: Baugruppentester		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 2 Messtechnik Antistatische Materialien Dienstleistungen Störfestigkeit	
Oktober mit CADS 3 Redaktionsschluss 18.09.2015 Anzeigenschluss 25.09.2015 Erscheinungstermin 01.10.2015	Vorberichte » productronica « Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Testsysteme, Lötssysteme Marktübersicht: Bestückssysteme	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		Semicon Europe 20.10. - 22.10.2015 Dresden
November mit EMV-ESD 4 MESSEHEFT »productronica 2015« Redaktionsschluss 16.10.2015 Anzeigenschluss 23.10.2015 Erscheinungstermin 02.11.2015	Vorberichte » productronica « Packaging, Bestückung, Leiterplattenfertigung, Schablonendruck, Photovoltaik Löttechnik, Lotpasten, neue Trends Marktübersicht: Leiterplattenhersteller		Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen Messtechnik Produktsicherheit	Motek 2015 05.10. - 08.10. 2015 Stuttgart productronica 2015 10.11. - 13.11.2015 München
Dezember mit CADS 4 Redaktionsschluss 27.11.2015 Anzeigenschluss 04.12.2015 Erscheinungstermin 14.12.2015	Nachberichte » productronica « Boardhandling, Bonding Löttechnik, Bestücktechnik Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan Marktübersicht: Bondsysteme	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		SPS/IPC/DRIVES 2015 24.11 - 26.11.2015 Nürnberg